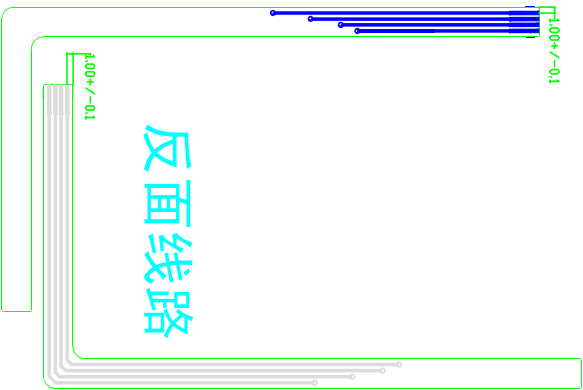
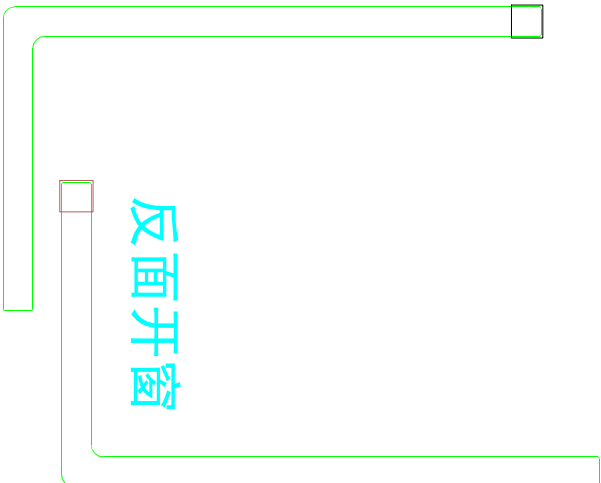


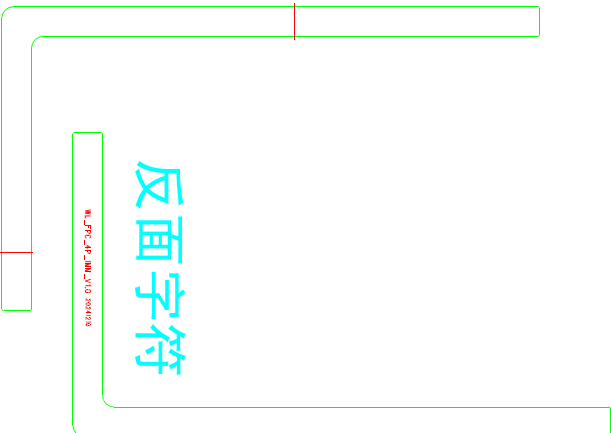
最小线宽：0.6±20%
最小线距：0.3±20%



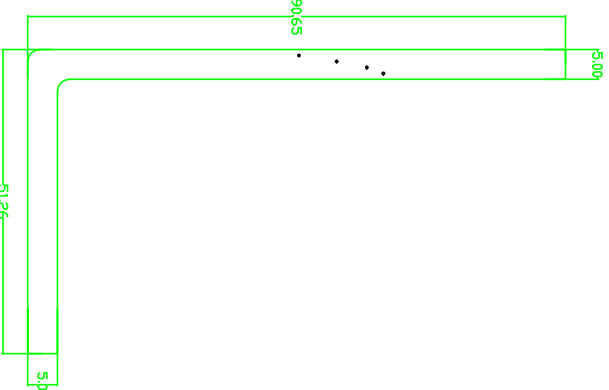
反面线路



反面开窗



反面字符



外形+钻孔

正面线路

正面开窗

正面字符

反面PI补强0.15mm
总厚度：0.3+/-0.03MM

正面TESA8853 0.05MM

说明：

- 产品类型：
- 工艺要求：沉金， NI：120-200U" AU：1-2U"
孔铜：8-12um

- 未标注外形公差：±0.1 mm
- 未标注线性公差：±0.02 mm
- 未标注开窗公差：±0.2 mm
- 未标注油墨公差：±0.2 mm

- FPC厚度：0.23±0.03
- 发放部门：■ 钻孔 ■ 曝光 ■ 蚀刻 ■ 贴合
■ 丝印 ■ 装配 ■ 冲切 ■ FQC ■ IPQC ■ FQA

深圳市森密志卓电子科技有限公司
SHENZHEN SENMI ZHI ZHUO ELECTRONIC CO., LTD.

设计	签名	日期	产品代号：S216137A	单位：mm
审核	谢日仟	2024.12.22	客户代号：	比例：N.T.S
批准			客户型号：	页次：1 / 1
			图名：单体图	版本号：A0